

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临2021-016

杭州士兰微电子股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 完成评估备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）持有的杭州集华投资有限公司19.51%的股权及杭州士兰集昕微电子有限公司20.38%的股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次重组相关事项已经公司于2020年12月30日召开的第七届董事会第十六次会议、2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会和2021年3月11日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。公司聘请的坤元资产评估有限公司出具了标的公司杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司的坤元评报〔2020〕742号和743号《资产评估报告》。具体内容详见公司于2020年12月31日、2021年1月23日和2021年3月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。

本次重组的交易对方大基金已于近日取得财政部经济建设司就本次交易涉及的上述资产评估报告下发的《国有资产评估项目备案表》。公司将继续积极有序推进本次重组的各项工作。

本次交易尚需经中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得该项核准，以及最终获得该项核准的时间尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021年3月27日